

Title (en)

Assembly with at least one semiconductor module and a transport package

Title (de)

Anordnung mit mindestens einem Leistungshalbleitermodul und mit einer Transportverpackung

Title (fr)

Agencement doté d'au moins un module semi-conducteur de puissance et d'un emballage de transport

Publication

EP 2347970 A1 20110727 (DE)

Application

EP 10192500 A 20101125

Priority

DE 102010005047 A 20100120

Abstract (en)

The arrangement (1) comprises a transportation packaging (2) provided with a planar sheet (10), a covering film (30), and a drip-tray type plastic structure (80). The plastic structure partly encloses the power semiconductor module (5). The side of power semiconductor module directly or indirectly rests on the major surface of the planar sheet. The farthest sides of power semiconductor module are covered by the covering film.

Abstract (de)

Die Anmeldung betrifft eine Anordnung mit mindestens einem Leistungshalbleitermodul und einer Transportverpackung, wobei das Leistungshalbleitermodul ein Bodenelement, ein Gehäuse und Anschlusselemente aufweist und wobei die Transportverpackung eine flächig ausgebildete Decklage, eine Deckfolie und mindestens einen wannenartigen Kunststoffformkörper pro Leistungshalbleitermodul aufweist. Hierbei umschließt dieser mindestens einen Kunststoffformkörper das zugeordnete Leistungshalbleitermodul nur teilweise und dabei liegt einen Teil des Kunststoffformkörpers nicht direkt an dem Leistungshalbleitermodul an. Weiterhin kommt hierbei eine erste Seite des mindestens einen Leistungshalbleitermoduls direkt oder indirekt auf der ersten Hauptfläche der Decklage zu liegen während die Deckfolie die weiteren Seiten des Leistungshalbleitermoduls direkt und / oder indirekt überdeckt, und hierbei zumindest teilweise an dem Kunststoffformkörper anliegt.

IPC 8 full level

B65D 75/32 (2006.01); **B65D 75/36** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

B65D 75/327 (2013.01 - EP KR US); **B65D 75/367** (2013.01 - EP KR US); **B65D 81/02** (2013.01 - KR); **B65D 85/30** (2013.01 - KR); **B65D 2575/3245** (2013.01 - KR); **B65D 2585/86** (2013.01 - EP KR US)

Citation (applicant)

- DE 3909898 A1 19900927 - SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH [DE]
- DE 19928368 A1 19991223 - HAWERA PROBST GMBH [DE]

Citation (search report)

- [Y] GB 1580791 A 19801203 - GILLETTE CO
- [Y] DE 102006020636 A1 20071108 - SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH [DE]
- [Y] US 6244442 B1 20010612 - INOUE ISAO [JP], et al

Cited by

US11769701B2

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2347970 A1 20110727; **EP 2347970 B1 20130619**; CN 102145794 A 20110810; CN 102145794 B 20150401; DE 102010005047 A1 20110721; DE 102010005047 B4 20141023; JP 2011173654 A 20110908; JP 5732261 B2 20150610; KR 20110085871 A 20110727; US 2011180918 A1 20110728; US 8247892 B2 20120821

DOCDB simple family (application)

EP 10192500 A 20101125; CN 201110025010 A 20110120; DE 102010005047 A 20100120; JP 2011005746 A 20110114; KR 20100137810 A 20101229; US 201113010621 A 20110120